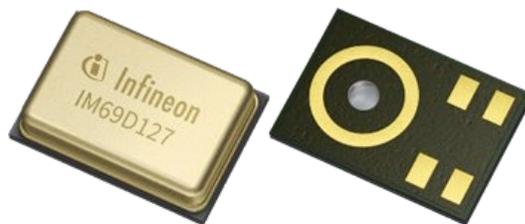


XENSIV™ MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127

IM69D127は、インフィニオンの新しいシールドデュアルメンブレンMEMS技術に基づくデジタル高性能MEMSマイクロフォンで、マイクロフォンレベルで高い防水/防塵性 (IP57) を実現しています。わずか3.6 x 2.5 x 1.0 mmの小型サイズのため、TWSイヤホンなどのコンパクトなオーディオ機器に最適な製品です。



主な特長

- > 非常に低い自己雑音／非常に高いSNR (69 dB)
- > バッテリー省電力が求められるアプリケーション向けに選択可能なパワーモード
- > SDM (Sealed Dual Membrane) 技術により、マイクロレベルではIP57の防塵性能を実現
- > 小型パッケージサイズ (3.6 × 2.5 × 1.0mm)
- > 非常に厳しい部分間の位相と感度のマッチング (±1dB)
- > LFRO (低域ロールオフ) が40Hzと低く、フラットな周波数特性
- > 非常に低い群遅延 (9μs)

対象アプリケーション

- > TWSイヤホン
- > ANCヘッドホン
- > ノートパソコン&タブレット
- > ウェアラブル

評価ボード

- > **KITIM69D127V11FLEXTOBO1**: XENSIV™ MEMSマイクロフォン5個をフレックスボードに実装、アダプターボード1個を搭載。

フレックス評価キットは、XENSIV™ MEMSマイクロフォンの評価を簡単かつ容易に行えるキットです。各フレックスボードに各タイプのマイクが1個ずつ実装されています。フレックスボードは、付属のアダプターボードを使い、6ポジションZIFコネクタを介してオーディオ試験装置に簡単に接続することができます。各キットにはフレックスボード5枚とアダプターボード1枚が含まれています。

製品概要および製品データシート ページへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IM69D127V11XTMA1	SP005405062	PG-TLGA-5
KITIM69D127V11FLEXTOBO1	SP005403891	

主な利点

- > 小さな音から大きな音まで、クリアな音質を実現
- > マイクロフォンレベルの小型パッケージと高い耐環境性 (IP57) を実現
- > 高度なオーディオ機能 (ANC、トランスペアレントヒアリング、オーディオズーム、ビームフォーミング) の有効化

製品関連情報 / オンライン サポート

[製品ページ](#)

[ボードページ](#)

【 XENSIV™ MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127】

FAQ

1. Why is Infineon launching own Microphone modules?

> We address high end use cases and drive high performance microphone innovations

2. MEMS Microphone Roadmap

> Infineon has a roadmap of multiple MEMS microphones for high performance low size and low power applications.